

ArChine Soldertech 100HB**亚群聚醚助焊液****产品描述**

ArChine Soldertech 100HB 是专业调制的聚醚类助焊液，设计用于作为回流焊液、沥青油、熔融流体和其他需要良好高温稳定性和水溶性的加工用流体的组份。

产品性质

- 良好热稳定性
- 低起泡性
- 高闪点
- 低气味
- 优异的可水洗特性
- 产品清晰度高

产品应用

ArChine Soldertech 100HB 有效作用于各种传热及灭火应用场合。其用作锡-铅电镀板和焊料层融合时的传热媒介并在组装时使焊料层及其性能维持原样。作为一个焊剂组份，焊接辅助液 **ArChine Soldertech 100HB** 帮助热传导并保护焊料不被氧化。其也用于光滑焊料表面及清洁镀通孔，减少焊料中浮渣的形成。

典型物理性质

外观	无色透明液体
密度, 20°C, g/cm ³	1.037
运动粘度@40°C, mm ² /s	96.60
运动粘度@100°C, mm ² /s	19.09
粘度指数	221
闪点 (开口, °C)	250
燃点, °C	270
倾点, °C	-45
铜片腐蚀 100°C, 3h	1 级

(1) 典型值不可作为筹备产品的规格。

(2) 产品含有少量不溶于水的添加剂以提高热稳定性能。